

Produktdatenblatt

hm2.0 unteres Schirmblech Bauform B25,
Art. Nr. 244-21600-1

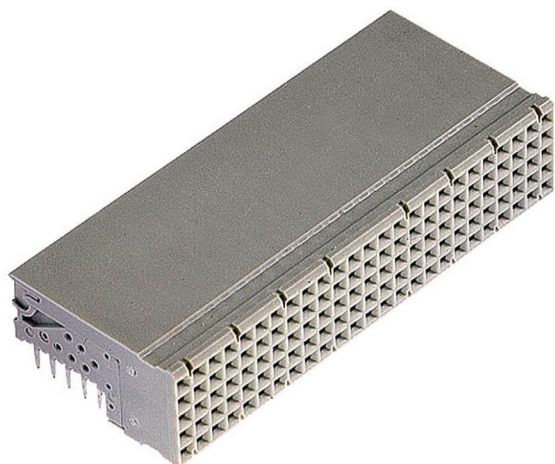


Abbildung ähnlich



Rechtwinklig



Einpresstechnik

- 25 Kontakte
- Anschlusslänge 3.4 mm
- für min 1.44 mm Leiterplattendicke
- getestet nach IEC 61076-4-101



» zum Produkt auf www.ept.de



» zur Produktgruppe hm 2.0

Produktdatenblatt

hm2.0 unteres Schirmblech Bauform B25,
Art. Nr. 244-21600-1



Technische Daten

Grundlagen

Spezifikation	IEC 61076-4-101
Gütestufe	2
Anzahl Kontakte	25
Anschlusstechnik	Einpresstechnik
Anschlusslänge	3.4 mm
Betriebstemperatur	-55°C bis +125°C

Material

Kontaktmaterial	Bronze
-----------------	--------

Mechanisch

Rastermaß	2.0 mm
Steckkraft pro Kontakt	Abschirmung: max. 1 N
Ziehkraft pro Kontakt	Abschirmung: min. 0.15 N
Lebensdauer	> 250 Steckzyklen

Elektrisch

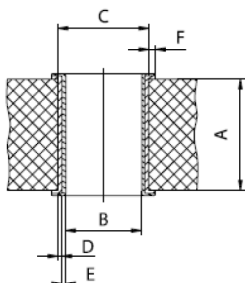
Betriebsstrom	1.5 A @ +20°C, 1.0 A @ +70°C
Durchgangswiderstand	max. 20 mΩ
Isolationswiderstand	min. 10 ⁴ MΩ
Prüfspannung	750 V r.m.s
Datenübertragung	3.125 Gbit/s

Zulassungen / Konformität

Umwelt	RoHS konform
--------	--------------

Lochspezifikation

Schichtaufbau nach IEC 60352-5



Material	chem. Sn Schicht
Nennloch	Ø 0.6 mm
A Leiterplattendicke	min 1.44 mm
B Endloch	Ø 0.60 ±0.05 mm
C Grundbohrung	0.70 ±0.02 mm
D Cu Schicht	min. 25 µm
E Oberfläche	max. 1.5 µm; chem. Sn Leiterplatten
F Restring	min. 0.1 mm

Material	Ni, Au Leiterplatten
Nennloch	Ø 0.6 mm
A Leiterplattendicke	min 1.44 mm
B Endloch	Ø 0.60 ±0.05 mm
C Grundbohrung	0.70 ±0.02 mm
D Cu Schicht	min. 25 µm
E Oberfläche	Ni, Au Schicht, 0.05 - 0.2 µm Au über 2.5 - 5 µm Ni
F Restring	min. 0.1 mm

Material	rein Cu Leiterplatten
Nennloch	Ø 0.6 mm
A Leiterplattendicke	min 1.44 mm
B Endloch	Ø 0.60 ±0.05 mm
C Grundbohrung	0.70 ±0.02 mm
D Cu Schicht	min. 25 µm
E Oberfläche	OSP*, z.B. GLICOAT-SMD (F2) mit 0.12 - 0.15 µm
F Restring	min. 0.1 mm

Material	HAL Sn Leiterplatten
Nennloch	Ø 0.6 mm
A Leiterplattendicke	min 1.44 mm
B Endloch	Ø 0.60 ±0.05 mm
C Grundbohrung	0.70 ±0.02 mm
D Cu Schicht	min. 25 µm
E Oberfläche	HAL Sn, 5 - 15 µm
F Restring	min. 0.1 mm

Produktdatenblatt

hm2.0 unteres Schirmblech Bauform B25,
Art. Nr. 244-21600-1



Zeichnungen

Die Kundenzeichnung zu diesem Produkt erhalten Sie auf Anfrage unter sales@ept.de